

VLSI TECHNOLOGY LLC v. INTEL CORP.事件、上訴番号2021-1826 (CAFC、2022年11月15日)。Bryson裁判官、Chen裁判官、Hughes裁判官による審理。PTABによる決定を不服としての上訴。

背景:

VLSI社は、特許を侵害したとしてIntel社を地方裁判所に提訴した。Intel社は、VLSI社の特許の主張クレームに対して異議を唱えて複数のIPRを申請した。PTABは、異議が唱えられた全てのクレームを特許取得性がないものとした。VLSI社は、PTABが2つのクレームの特徴を適切に解釈していないと主張し、上訴した。

今回の対象であるクレームに記載の特徴は、(1)「少なくともボンドパッドの下の、ボンドパッドに加えらるる応力による欠陥の影響を受けやすいことを特徴とする力領域(a force region at least under the bond pad characterized by being susceptible to defects due to stress applied to the bond pad)」および(2)「レイアウトが、複数のボンドパッドの第1のボンドパッドの下に延びる複数の金属含有相互接続層からなり、前記複数の金属含有相互接続層の少なくとも一部が前記第1のボンドパッドの下にあり、ボンドパッドに直接接続されない電気相互接続に用いられる結果として第1のボンドパッドに電気接続しない(wherewithin the layout comprises a plurality of metal-containing interconnect layers that extend under a first bond pad of the plurality of bond pads, at least a portion of the plurality of metal-containing interconnect layers underlying the first bond pad and not electrically connected to the first bond pad as a result of being used for electrical interconnection not directly connected to the bond pad)」ことである。

争点/判決:

PTABは、「力領域(force region)」という特徴の解釈を誤ったか。否、原決定が確認支持された。PTABは、「電気相互接続に用いられる(used for electrical interconnection)」という特徴の解釈を誤ったか。然り、原決定は覆され、差し戻しとなった。

審理内容:

地方裁判所は、「力領域(force region)」を「集積回路内で、ダイアタッチ(die attach)を行う際に相互接続構造に応力が作用する領域(region within the integrated circuit in which forces are exerted on the interconnect structure when a die attach is performed)」と解釈した。PTABでは、当事者同士はこの解釈に一部同意したが、ダイアタッチの解釈については争った。Intel社は、ワイヤーボンディングなど、チップを他の電子部品に取り付けるあらゆる方法を含む広義の解釈を主張した。これに対して、VLSI社は、「ダイアタッチ(die attach)」が特定の取り付け方法、すなわち「フリップチップボンディング(flip-chip bonding)」のみを指すとする狭義の解釈を主張した。PTABは、Intel社のクレーム解釈を採用した。

CAFCは、今回の訴訟対象特許中の内在的証拠により、PTABのクレーム解釈を確認支持した。明細書には、ダイアタッチの一例としてワイヤーボンディングが具体的に開示されており、本発明がフリップチップボンディングに限定されないことが明らかにされていた。従って、クレームに記載の「力領域(force region)」内で使用されるボンディングの複数の例が存在するため、比較的広義のクレーム解釈が適切であった。

クレームに記載の第2の特徴について、PTABは、「used for electrical interconnection not directly connected to the bond pad」というフレーズを、「互いに電氣的に接続されているが、ボンドパッドや他のアクティブ回路には電氣的に接続されていない相互接続層」を意味すると解釈した。VLSI社は、PTABの解釈は広すぎると主張した。

CAFCはVLSI社に同意した。まず、「電気相互接続に用いられる(used for electrical interconnection)」という文言は、相互接続層が電気を運ぶことを意味する。次に、クレームは、電気を運ばない「ダミー金属線(dummy metal lines)」にも言及している。PTABのクレーム解釈によると、相互接続層は「ダミー金属線(dummy metal lines)」と何ら変わりはなく、冗長なクレーム解釈は好ましくない。

'552特許の注釈付き図1

